

# 2022-2028年中国集成电路 市场分析与投资可行性报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2022-2028年中国集成电路市场分析与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202206/302126.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特·诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

中企顾问网发布的《2022-2028年中国集成电路市场分析与投资可行性报告》共十八章。首先介绍了集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了集成电路行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 集成电路基本情况

#### 1.1 集成电路的相关介绍

##### 1.1.1 集成电路概念

##### 1.1.2 集成电路行业

#### 1.2 集成电路产品流程及产业链结构

##### 1.2.1 集成电路产品流程

##### 1.2.2 集成电路产业链结构

### 第二章 2016-2020年集成电路发展环境分析

#### 2.1 宏观经济环境

##### 2.1.1 全球经济发展形势

##### 2.1.2 中国宏观经济概况

- 2.1.3 中国工业运行情况
- 2.1.4 中国经济发展展望
- 2.2 政策环境分析
  - 2.2.1 产业相关政策汇总
  - 2.2.2 企业免税政策分析
  - 2.2.3 产业的国家发展战略
  - 2.2.4 “十四五”发展规划
- 2.3 产业发展环境
  - 2.3.1 电子信息产业与集成电路
  - 2.3.2 智能化带动集成电路发展
  - 2.3.3 区块链发展带来产业新增量

### 第三章 2016-2020年半导体行业发展分析

- 3.1 2016-2020年全球半导体行业分析
  - 3.1.1 半导体市场发展规模
  - 3.1.2 半导体产业区域分析
  - 3.1.3 半导体产品结构分析
  - 3.1.4 半导体与集成电路
- 3.2 2016-2020年中国半导体行业分析
  - 3.2.1 产业发展态势
  - 3.2.2 产业规模现状
  - 3.2.3 市场发展动力
  - 3.2.4 产业发展趋势
- 3.3 2016-2020年半导体材料行业分析
  - 3.3.1 半导体材料的重要意义
  - 3.3.2 半导体材料行业的特点
  - 3.3.3 全球半导体材料市场
  - 3.3.4 中国半导体材料市场
  - 3.3.5 中国半导体材料国产化
  - 3.3.6 半导体材料与集成电路

### 第四章 2016-2020年全球集成电路产业发展分析

- 4.1 全球集成电路产业分析
  - 4.1.1 全球销售规模分析
  - 4.1.2 全球产品结构分析
  - 4.1.3 全球细分市场规模
- 4.2 美国集成电路产业分析
  - 4.2.1 产业发展概况
  - 4.2.2 产业发展模式
  - 4.2.3 产业技术计划
- 4.3 台湾集成电路产业分析
  - 4.3.1 产业发展基本情况
  - 4.3.2 IC设计业发展现状
  - 4.3.3 晶圆代工业发展现状
  - 4.3.4 封装测试业发展现状
- 4.4 其他国家集成电路产业分析
  - 4.4.1 韩国集成电路产业概况
  - 4.4.2 日本集成电路产业分析

## 第五章 2016-2020年中国集成电路产业发展分析

- 5.1 集成电路产业发展综述
  - 5.1.1 产业发展历程
  - 5.1.2 产业发展意义
- 5.2 集成电路所属产业运行规模分析
  - 5.2.1 市场销售规模
  - 5.2.2 进口规模分析
  - 5.2.3 出口规模分析
  - 5.2.4 产业结构分析
- 5.3 集成电路市场竞争分析
  - 5.3.1 行业进入壁垒的提高
  - 5.3.2 上游行业垄断程度高
  - 5.3.3 行业内竞争持续加剧
  - 5.3.4 企业盈利能力增强
  - 5.3.5 研发投入持续增长

## 5.4 集成电路产业发展问题及发展策略

### 5.4.1 产业发展问题

### 5.4.2 产业发展策略

## 5.5 集成电路产业核心竞争力提升方法

### 5.5.1 提高扶持资金集中运用率

### 5.5.2 制定融资投资制度

### 5.5.3 提高政府采购力度

### 5.5.4 建立技术中介服务制度

### 5.5.5 人才引进与人才培养

## 第六章 2016-2020年中国集成电路主要城市分析

### 6.1 北京

#### 6.1.1 产业发展现状

#### 6.1.2 产业市场规模

#### 6.1.3 产业发展特点

#### 6.1.4 产业发展瓶颈

#### 6.1.5 产业发展对策

### 6.2 上海

#### 6.2.1 产业发展规模

#### 6.2.2 产业发展预测

#### 6.2.3 技术发展预测

#### 6.2.4 产业发展思路

#### 6.2.5 发展措施及建议

### 6.3 深圳

#### 6.3.1 产业政策环境

#### 6.3.2 产业发展现状

#### 6.3.3 产业发展规模

#### 6.3.4 产业发展目标

#### 6.3.5 产业发展动态

### 6.4 杭州

#### 6.4.1 产业发展背景

#### 6.4.2 行业发展现状

- 6.4.3 行业发展问题
- 6.4.4 发展对策建议
- 6.5 厦门
  - 6.5.1 产业发展政策
  - 6.5.2 产业发展规模
  - 6.5.3 产业优劣势分析
  - 6.5.4 产业发展建议
- 6.6 其他
  - 6.6.1 江苏
  - 6.6.2 湖南
  - 6.6.3 湖北武汉
  - 6.6.4 安徽合肥
  - 6.6.5 广东珠海

## 第七章 2016-2020年集成电路行业产品介绍

- 7.1 微处理器（MPU）
  - 7.1.1 CPU
  - 7.1.2 AP（APU）
  - 7.1.3 GPU
  - 7.1.4 MCU
  - 7.1.5 DSP
- 7.2 存储器
  - 7.2.1 存储器发展规模
  - 7.2.2 动态随机存取存储器（DRAM）
  - 7.2.3 存储器市场需求分析
  - 7.2.4 存储器市场份额划分
  - 7.2.5 存储器在手机中的应用
- 7.3 NAND Flash（NAND闪存）
  - 7.3.1 全球NAND Flash市场规模
  - 7.3.2 全球闪存的主要供应厂商
  - 7.3.3 全球闪存的技术发展
  - 7.3.4 全球主要厂商表现

## 7.4 其他细分市场产品

### 7.4.1 存储芯片

### 7.4.2 逻辑芯片

### 7.4.3 处理芯片

### 7.4.4 模拟芯片

## 第八章 2016-2020年集成电路行业细分&mdash;&mdash;集成电路设计业

### 8.1 集成电路设计介绍

### 8.2 集成电路设计业市场发展分析

#### 8.2.1 行业销售规模

#### 8.2.2 区域发展格局

#### 8.2.3 主要城市分析

### 8.3 集成电路设计企业规模分析

#### 8.3.1 设计企业规模

#### 8.3.2 企业区域格局分析

#### 8.3.3 企业从业人员规模

#### 8.3.4 主要企业销售规模

#### 8.3.5 各领域企业的规模

### 8.4 集成电路设计产业园区介绍

#### 8.4.1 辽宁集成电路设计产业基地

#### 8.4.2 北京中关村集成电路设计园

#### 8.4.3 深圳集成电路设计应用产业园

## 第九章 2016-2020年集成电路行业核心&mdash;&mdash;集成电路制造业

### 9.1 集成电路制造业发展情况分析

#### 9.1.1 集成电路制造业基本概念

#### 9.1.2 集成电路制造业增长原由

#### 9.1.3 集成电路制造业重要性

#### 9.1.4 集成电路制造业工艺技术

### 9.2 集成电路制造业发展规模分析

#### 9.2.1 市场发展规模分析

#### 9.2.2 主要企业销售规模



- 9.2.3 市场投资建设规模
- 9.3 集成电路制造业发展问题分析
  - 9.3.1 市场份额较低
  - 9.3.2 产业化进程缓慢
  - 9.3.3 缺乏复合型人才
- 9.4 集成电路制造业发展思路及建议
  - 9.4.1 国家和地区设计有机结合
  - 9.4.2 坚持密切贴合产业链需求
  - 9.4.3 产业体系生态建设与完善
  - 9.4.4 依托相关政策推动国产化
  - 9.4.5 整合力量推动创新发展

## 第十章 2016-2020年集成电路行业细分——晶圆制造业

- 10.1 晶圆制造行业发展综述
  - 10.1.1 晶圆制造行业概述
  - 10.1.2 晶圆制造工艺分析
  - 10.1.3 晶圆加工技术介绍
- 10.2 全球晶圆制造业市场发展情况分析
  - 10.2.1 全球晶圆产能格局
  - 10.2.2 全球晶圆消费格局
  - 10.2.3 企业竞争情况分析
- 10.3 中国晶圆制造市场发展情况分析
  - 10.3.1 中国晶圆生产线规模
  - 10.3.2 中国晶圆设备的需求
  - 10.3.3 中国晶圆工厂的分布
- 10.4 晶圆制造行业发展趋势分析
  - 10.4.1 全球市场发展趋势
  - 10.4.2 全球市场发展预测
  - 10.4.3 中国市场发展预测

## 第十一章 2016-2020年集成电路行业细分——封装测试业

- 11.1 集成电路封装测试行业发展综述

- 11.1.1 封装测试业发展概况
- 11.1.2 封装测试业的重要性
- 11.1.3 封装测试行业竞争特征
- 11.2 中国集成电路封装测试市场发展分析
  - 11.2.1 市场发展态势分析
  - 11.2.2 市场发展规模分析
  - 11.2.3 主要企业收入规模
- 11.3 集成电路封装测试业技术发展分析
  - 11.3.1 技术最新发展情况
  - 11.3.2 未来产品的发展趋势
  - 11.3.3 存在的技术挑战
- 11.4 先进封装与系统集成创新平台
  - 11.4.1 中心基本情况
  - 11.4.2 中心基础建设
  - 11.4.3 中心服务状况
  - 11.4.4 中心创新机制
  - 11.4.5 中心专利成果

## 第十二章 2016-2020年集成电路其他相关行业分析

- 12.1 2016-2020年传感器行业分析
  - 12.1.1 行业发展基本态势
  - 12.1.2 全球行业发展规模
  - 12.1.3 全球市场竞争格局
  - 12.1.4 中国市场发展规模
  - 12.1.5 中国市场竞争格局
  - 12.1.6 行业未来发展趋势
- 12.2 2016-2020年分立器件行业分析
  - 12.2.1 行业的发展概况
  - 12.2.2 行业的发展现状
  - 12.2.3 分立器件市场规模
  - 12.2.4 产业链上游分析
  - 12.2.5 产业链下游分析

- 12.2.6 主要供应商分析
- 12.3 2016-2020年光电器件行业分析
  - 12.3.1 行业政策环境
  - 12.3.2 行业发展现状
  - 12.3.3 行业产量规模
  - 12.3.4 发展问题及挑战
  - 12.3.5 行业发展策略
- 12.4 2016-2020年芯片行业发展分析
  - 12.4.1 全球市场规模
  - 12.4.2 中国产业规模
  - 12.4.3 中国市场需求
  - 12.4.4 产业发展困境
  - 12.4.5 发展应对策略
- 12.5 2016-2020年硅片产业发展分析
  - 12.5.1 硅片市场发展现状
  - 12.5.2 硅片市场供需情况
  - 12.5.3 硅片市场发展机遇
  - 12.5.4 硅片与集成电路的关系

### 第十三章 2016-2020年集成电路技术分析

- 13.1 集成电路技术综述
  - 13.1.1 技术联盟成立
  - 13.1.2 技术应用分析
- 13.2 集成电路前道制造工艺技术
  - 13.2.1 微细加工技术
  - 13.2.2 电路互联技术
  - 13.2.3 器件特性的退化
- 13.3 集成电路后道制造工艺技术
  - 13.3.1 3D集成技术
  - 13.3.2 晶圆级封装
- 13.4 集成电路的ESD防护技术
  - 13.4.1 集成电路的ESD现象成因

- 13.4.2 集成电路ESD的防护器件
- 13.4.3 基于SCR的防护技术分析
- 13.4.4 集成电路全芯片的防护技术
- 13.5 集成电路技术发展趋势及前景展望
  - 13.5.1 技术发展趋势
  - 13.5.2 技术发展前景
  - 13.5.3 技术市场展望

## 第十四章 2016-2020年集成电路应用市场发展分析

- 14.1 汽车工业
  - 14.1.1 汽车工业所属行业产销状况分析
  - 14.1.2 汽车工业所属行业进出口状况分析
  - 14.1.3 汽车工业所属行业经济效益分析
  - 14.1.4 集成电路在汽车的应用状况
- 14.2 通信行业
  - 14.2.1 通信业总体情况
  - 14.2.2 通信业网络设施
  - 14.2.3 集成电路应用状况
- 14.3 消费电子
  - 14.3.1 消费电子市场发展状况
  - 14.3.2 智能手机集成电路应用分析
  - 14.3.3 电源管理IC市场分析
  - 14.3.4 消费电子类集成电路技术分析
- 14.4 医学应用
  - 14.4.1 医学的应用概况
  - 14.4.2 便携式医疗仪器
  - 14.4.3 可穿戴式医疗仪器
  - 14.4.4 植入式医疗仪器
  - 14.4.5 仿生器官芯片
  - 14.4.6 医学应用发展趋势

## 第十五章 国外集成电路产业重点企业经营分析

- 15.1 英特尔 ( Intel )
  - 15.1.1 企业发展概况
  - 15.1.2 企业经营状况分析
- 15.2 亚德诺 ( ADI )
  - 15.2.1 企业发展概况
  - 15.2.2 企业经营状况分析
- 15.3 SK海力士 ( SKhynix )
  - 15.3.1 企业发展概况
  - 15.3.2 企业经营状况分析
- 15.4 恩智浦 ( NXP Semiconductors N.V. )
  - 15.4.1 企业发展概况
  - 15.4.2 企业经营状况分析
- 15.5 德州仪器 ( TEXAS INSTRUMENTS INC )
  - 15.5.1 企业发展概况
  - 15.5.2 企业经营状况分析
- 15.6 英飞凌 ( Infineon Technologies AG )
  - 15.6.1 企业发展概况
  - 15.6.2 企业经营状况分析
- 15.7 意法半导体集团 ( STMicroelectronics )
  - 15.7.1 企业发展概况

## 第十六章 中国集成电路产业重点企业经营分析

- 16.1 中芯国际集成电路制造有限公司
  - 16.1.1 企业发展简况分析
  - 16.1.2 企业经营情况分析
  - 16.1.3 企业经营优劣势分析
- 16.2 杭州士兰微电子股份有限公司
  - 16.2.1 企业发展简况分析
  - 16.2.2 企业经营情况分析
  - 16.2.3 企业经营优劣势分析
- 16.3 上海贝岭股份有限公司
  - 16.3.1 企业发展简况分析

- 16.3.2 企业经营情况分析
- 16.3.3 企业经营优劣势分析
- 16.4 江苏长电科技股份有限公司
  - 16.4.1 企业发展简况分析
  - 16.4.2 企业经营情况分析
  - 16.4.3 企业经营优劣势分析
- 16.5 吉林华微电子股份有限公司
  - 16.5.1 企业发展简况分析
  - 16.5.2 企业经营情况分析
  - 16.5.3 企业经营优劣势分析
- 16.6 中电广通股份有限公司
  - 16.6.1 企业发展简况分析
  - 16.6.2 企业经营情况分析
  - 16.6.3 企业经营优劣势分析

## 第十七章 2016-2020年集成电路产业投融资分析

- 17.1 集成电路产业投融资环境分析
  - 17.1.1 产业固定资产投资规模
  - 17.1.2 产业设立投资基金
  - 17.1.3 产业项目建设情况
- 17.2 集成电路行业投资特性分析
  - 17.2.1 周期性
  - 17.2.2 区域性
  - 17.2.3 特有模式
  - 17.2.4 资金密集性
  - 17.2.5 其他特性
- 17.3 集成电路产业投资基金分析
  - 17.3.1 北京产业基金
  - 17.3.2 上海产业基金
  - 17.3.3 广东产业基金
  - 17.3.4 陕西产业基金
  - 17.3.5 其他区域基金

- 17.4 集成电路产业投资机遇分析
  - 17.4.1 万物互联形成战略新需求
  - 17.4.2 人工智能开辟技术新方向
  - 17.4.3 协同开放构建研发新模式
  - 17.4.4 新旧力量塑造竞争新格局

## 第十八章 2022-2028年集成电路产业发展趋势及前景预测 ( )

- 18.1 集成电路产业发展趋势分析
  - 18.1.1 产业发展战略布局
  - 18.1.2 产业发展趋势变化
  - 18.1.3 产业模式变化分析
- 18.2 集成电路产业发展前景预测
  - 18.2.1 全球市场发展预测
  - 18.2.2 2022-2028年中国集成电路市场发展规模预测

### 部分图表目录：

- 图表 集成电路完整产品流程图
  - 图表 集成电路完整产业链结构
  - 图表 2016-2020年国内生产总值及其增长速度
  - 图表 2016-2020年三次产业增加值占全国生产总值比重
  - 图表 2016-2020年全部工业增加值及其增速
  - 图表 中国集成电路行业主要政策汇总
  - 图表 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标
  - 图表 《中国集成电路产业“十四五”发展规划建议》发展目标
  - 图表 2016-2020年全球半导体市场规模及增速
  - 图表 2020年半导体销售额分地区占比
  - 图表 2020年半导体分地区销售额增速
  - 图表 2020年全球半导体产品结构
  - 图表 2020年半导体市场分类增速
- 更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202206/302126.html>